

长电2N7002K

产品名称	长电2N7002K
公司名称	深圳市合通泰电子有限公司
价格	.15/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡街道共和工业路华丰互联网创意园A503
联系电话	0755-82965240 18145855552

产品详情

封装的WLCSP一种创新的FIWLP封装，采用扇出工艺来创建这种创新而强大的封装WLCSP封装。-标准晶圆级CSP封装。低固化温度聚合物等工艺技术的发展以及在凸点下金属化和RDL中使用铜的使用，可以实现更高的密度并提高WLCSP封装的可靠性。工艺还可以产生称为2.5D eWLB的创新过渡技术，其中使用薄膜扇出结构可实现高密度互连。JCET的芯片级集成产品组合。基于eWLB的插入器可简化材料供应链并降低总体成本，为客户将其设备转换为更高级的2.5D和3D封装提供了强大的技术平台和途径。